

# RQ5249-145

# 高性能AI液冷工作站

面向高性能、灵活扩展而设计的 新一代硬件算力平台

- ✓ 极致CPU TDP支持,至高350W
- ✓ CPU、GPU独立液冷散热
- ☑ 低能低耗,办公环境使用
- ☑ 整机液冷方案
- ▼ 噪音低至20db-55db



## 产品概述

### ▶ 全新处理架构

采用Intel第五代/第四代 Xeon Scalable系列处理器,TDP可达350W,为用户的各项应用提供更高的性能。该处理器同前代产品相比,可支持更多CPU核心和DDR5 4800内存,极大地提高了系统性能,大幅提升CPU之间的协作效率,在大规模并发处理上,有着特别优越的性能。

#### ▶ 丰富的可扩展性

4个PCle 5.0x 16 和 2个PClE 5.0x 8 插槽为系统提供丰富的扩展接口,最高支持2块液冷式GPU计算卡,最高支持2个3.5"非热插拔 HDD,3个2.5"非热插拔SSD,2个M.2 SSD

### ▶ 液冷设计、静音办公

采用CPU和GPU整体液冷方案,性能与静音兼备,经济环保,有效节约用电成本,从而为您最大限度优化 TCO 成本。

#### ▶ 高应用场景

工程(3D建模、结构分析、公共工程)、金融(股市行情预测、 经济模型/预测、高频交易)、影音制作(非线编辑、影视设计、 3D建模、虚拟现实)、科研(人工智能/深度学习、生物学DNA、 天气预测)、工业计算机(医疗检测设备、自动化/EDA,CAD)。

# 融科联创智·算力量







产品规格	RQ5249-I45服务器
处理器	支持2颗第 4 代 /第 5 代 Intel® Xeon® 可扩展处理器, 最高64C/128T;每个 CPU 高达 320MB 缓存(依CPU型号不同而不同)
芯片组	Intel C741系列芯片组
内存	16根内存插槽 支持DDR5 RDIMM/3DS RDIMM 5600/5200/4800/4400/4000MHz ECC内存 (工作频率依CPU和内存配置不同而不同) 最大可扩至4TB ECC RDIMM,支持RDIMM、3DSRDIMM
网络	板载集成双千兆电口
PCIe 扩展	最大支持6个PCle扩展插槽,4个PCle 5.0 x16,,2个PCle ,5.0 x8
GPU 扩展	最高支持2张双宽液冷GPU卡
存储控制器	SAS卡, 支持RAID 0/1/5/10 SAS RAID卡, 支持RAID 0/1/5/6/50/60 支持Cache超级电容保护, 提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能
硬盘方案	最高支持2个3.5''非热插拔HDD,3个2.5''非热插拔SSD,2个M.2 SSD
其他端口	机箱前端: 2个USB 3.0 Type-A 接口, 1个USB-C GEN2接口 机箱后端: 1个RJ45管理接口,4个USB 3.0接口 1 x COM 口,1 x IPMI 口 2 x RJ45千兆网口,1 x VGA 口
电源	1个ATX电源
电源电压	100-240Vac
散热	CPU液冷、GPU液冷
管理功能	集成BMC芯片,支持IPMI 2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能,对外提供1个1Gbps RJ45管理口,可支持NCSI功能
机箱	工作站机箱
机箱尺寸	560mm(长)x580mm(高)x240mm(宽)
满配质量	25Kg
工作温度	工作温度: 10°C∽35°C(50°F∽95°F) 非工作温度: -40°C至60°C(-40°F至140°F)
支持操作系统	Microsoft Windows Server / RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server / CentOS Linux Vmware ESXi / Ubuntu Linux (更多软件兼容性信息,请联系融科联创公司技术中心)

Copyright © 2025 融科联创(天津)信息技术有限公司 保留一切权利

更多产品信息,请查询公司官网或来电咨询 www.roycom.com.cn 400-018-8995

